



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2021 年第一季度自结财务报告

2021 年 4 月 29 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(29)日公告 2021 年第一季度自结财务报告。

2021 年第一季度财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 60.09 亿元，较前季减少 12%，较去年同期减少 1%
- ◆ 本季合并毛利率为 33.5%，较前季减少 1.5 个百分点；本季营业净利率为 19.9%，较前季减少 4.4 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 11.96 亿元，较前季减少 28%，较去年同期减少 38%
- ◆ 本季税后净利为新台币 10.95 亿元，较前季减少 14%，较去年同期减少 30%；每股盈余为新台币 2.72 元，前季为新台币 3.07 元

2021 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第二季营收预计较前一季增加 low-single digit 百分比。
- ◆ 第二季毛利率预计约为 low-thirties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“在传统淡季的效应之下，稳懋2021年第一季各项产品营收均因为季节性因素同步较前一季下滑，5G PA出货占整体Cellular营收也略低于20%，第一季营收为新台币60.09亿元，如预期较上一季减少12%，略低于前一年同期约1%。在产品组合及产能利用率影响之下，毛利率较上一季下滑到33.5%。随着营收下滑加上费用上升，第一季营业净利率为19.9%，季减4.4个百分点，EPS则为新台币2.72元。

综观第一季各项产品组合中，Cellular及Wi-Fi营收较前一季下滑情形相对轻微，主要是因为自去年开始全球在历经新冠疫情肆虐至今，在家工作(WFH)及在线教学(LFH)成为新常态，在无线连网装置长时间大量影音数据传输的需求之下，无论是手持式装置、Wi-Fi基地台、物联网应用等，追求更好更稳定的联机质量成为关键，而稳懋长期提供高质量高效能的功率放大器等无线通信芯片成为市场首选。另外，从去年到现在，尽管在国际政治的角力中，终端品牌手机市场占有率版图快速更迭，多家亚洲客户因而受惠需求不断提升，稳懋得力于分散的客户结构、技术及产能的优势，始终扮演着重要的角色。稳懋今年积极规划南科高雄园区新厂的开发，预计将于年中正式动工，就是为了满足客户对于产能的长期需求，也为稳懋未来的持续成长奠定基础。

展望2021年第二季，我们预计营收将较上一季增加 low-single digit 百分比，预计毛利率约为 low-thirties 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。